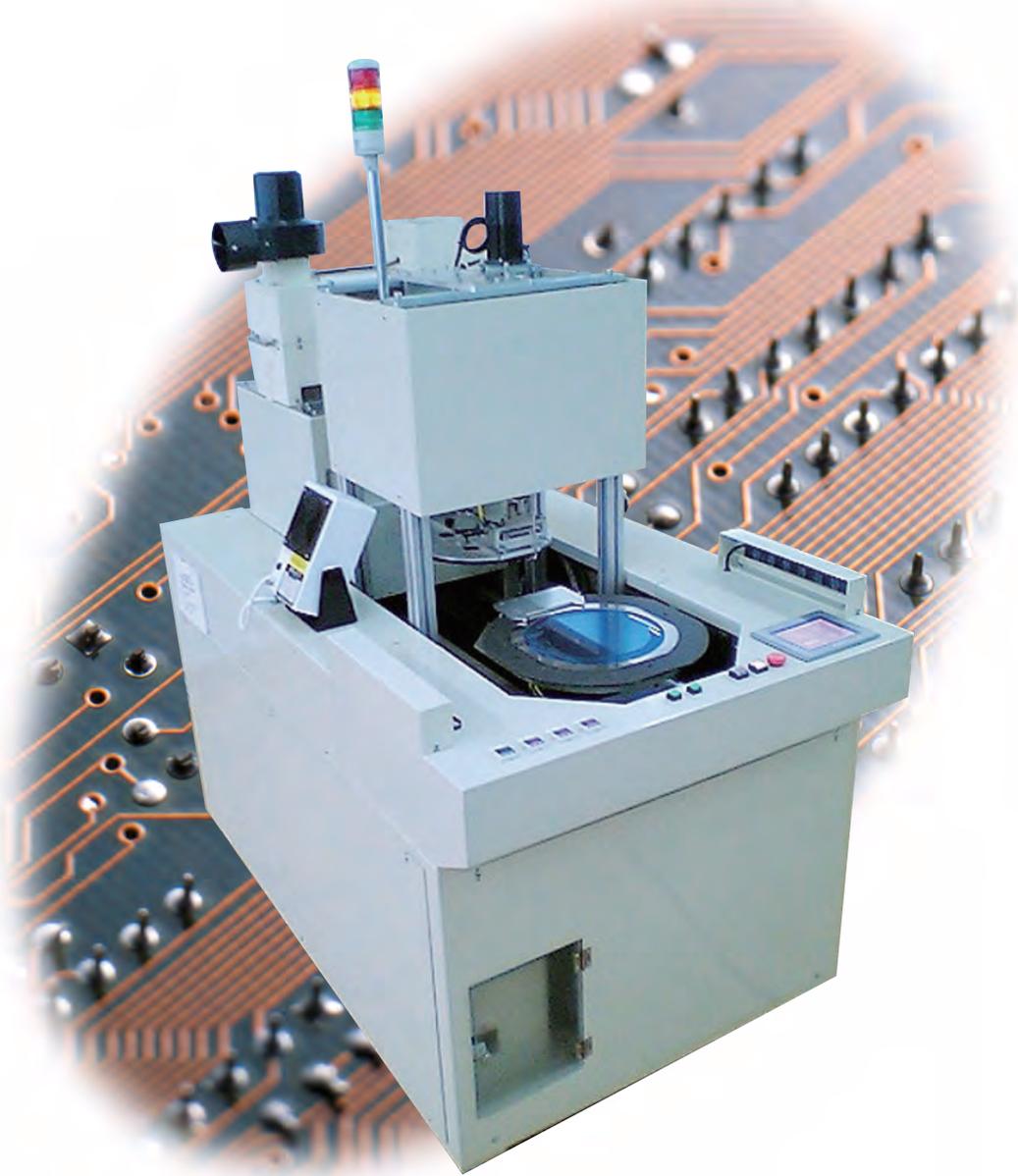


MODEL GWSM-300R1

ウェーハ/支持基板剥離装置

概要

本装置は、B/G工程の前装置としてウェーハ薄厚化に対応する為、予め特殊両面テープが貼付けられたウェーハと支持基板を真空状態内において貼り合わせを行う装置である。



仕 様	GWSM-300R1
スループット	約 10 ~ 15 枚/h
対応ウェーハサイズ	8・12インチ
装置寸法	D1,500 × W910 × H1,750mm
重 量	約400kg

※ 外観・仕様は改良の為、予告なく変更する場合があります。